

半導體產業鏈訪廠交流委託案

一、採購規格

1. 目的

本委託案主要透過拜訪國內半導體產業鏈相關廠商，瞭解半導體關鍵模組之技術發展、產品應用、產業需求及供應鏈現況，並蒐集業者對關鍵模組自主化、國產化及未來發展方向之看法。

藉由訪廠交流掌握國內業者於半導體關鍵模組之技術能量與發展需求，作為後續研究規劃、技術布局及產業推動之參考。

2. 工作內容

A. 前置作業

- 盤點國內半導體產業鏈及關鍵模組相關廠商，掌握主要業者、產品類型及技術發展概況。
- 依據廠商之技術代表性、產品應用、產業布局及與半導體關鍵模組之關聯性，篩選具代表性之訪談對象。
- 選定至少 5 家國內半導體產業鏈相關廠商，作為本案主要訪廠交流對象。
- 蒐集受訪廠商之公司背景、主要產品、核心技術、應用領域及半導體市場布局等基本資訊。
- 整理各受訪廠商於半導體關鍵模組供應鏈中的角色，以及其主要產品與技術定位。
- 依據技術發展方向與受訪廠商特性，規劃各場次訪談及交流主題。
- 擬定訪談題綱，內容包含技術發展、產品應用、市場需求、供應鏈合作、自主化及國產化等相關議題。
- 辦理訪廠前之聯繫、議程確認及相關交流資料準備。

B. 訪談交流

- 透過實地訪廠及交流方式，瞭解廠商目前投入半導體關鍵模組之產品、技術及應用情形。
- 瞭解關鍵模組於半導體設備或製程中的主要功能、應用需求及技術發展方向。
- 訪談廠商在關鍵模組產品開發、設計、生產、測試及導入過程中所面臨之技術問題。
- 蒐集業者對於產品精度、穩定性、可靠度、潔淨度及設備整合等相關需求之看法。
- 瞭解相關產品進入半導體供應鏈所需之驗證流程、客戶要求及市場導入條件。
- 訪談國內業者在關鍵模組自主化及國產化發展過程中所面臨之主要挑戰。
- 瞭解目前關鍵模組、零組件、材料或相關技術對國外供應之依賴情形。

- 蒐集業者對國內供應鏈缺口、技術瓶頸及未來可能發展機會之觀察。
- 瞭解先進製程、先進封裝及新世代半導體設備發展，對關鍵模組技術規格與產品需求可能產生之影響。
- 蒐集業者對未來半導體關鍵模組技術發展、市場趨勢及產業合作方向之看法。
- 瞭解業者在技術研發、產品驗證、人才、產學研合作及相關資源方面之需求。
- 就訪談過程所取得之重要資訊、產業意見及發展議題進行紀錄與整理。

C. 成果整理

- 彙整各場次訪廠交流內容及業者意見。
- 整理半導體關鍵模組相關技術、產品及產業發展觀察。
- 彙整國內廠商之發展需求、技術議題及供應鏈相關意見。
- 完成訪廠紀錄報告一份，供後續研究及產業規劃參考。

二、書審項目：

本案規範書加入書審項目如下表，由廠商提供企畫書供本案相關委員書審，以利選出更符合本案之廠商

項目	主軸	內容	比重	評分
1	服務內容規劃之合理性與可行性	1.對服務事項之瞭解程度、專業性、可行性及合理性(20%) 2.工作計畫及進度流程控管(20%)	40	
2	專案計畫執行能力	執行團隊成員之專長、經驗與人力配置	30	
3	過往實績	過去執行專案計畫實績	10	
4	預算	預算合理性	20	

三、驗收規範及付款方式

1. 驗收規範

完成本案所規劃之半導體產業鏈廠商訪廠交流及相關資料整理工作，並繳交「訪廠紀錄報告」一份。

2. 付款方式



A532004746

本案付款方式採一期付款，完成全部工作並經驗收合格後，一次支付契約總價之 100%。

3. 成果交付

依契約期限 2026/12/15 前繳交「訪廠紀錄報告」一份。

